



特性

- 》优异的热传导率
- 》超柔软和高顺应性
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高绝缘性能

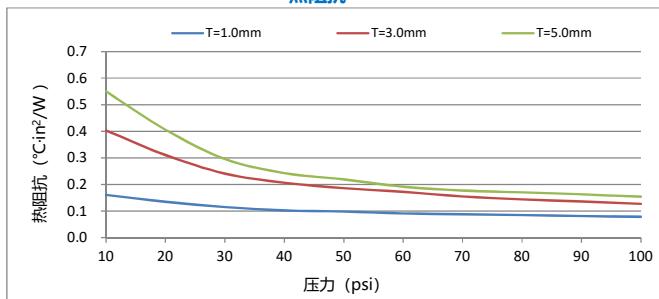
应用

- 》AI服务器
- 》半导体封装
- 》低空飞行器
- 》光通信产品
- 》5G基站

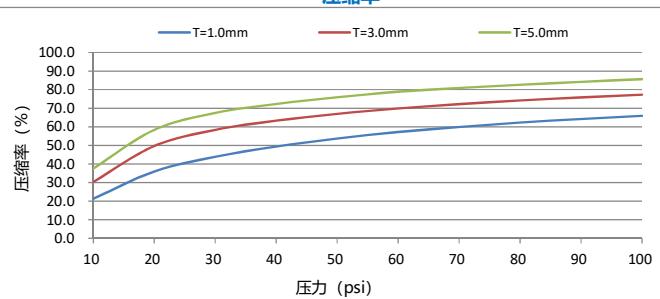
TIF®700PLUS 一款超软态导热界面材料，专为保护对机械应力极其敏感的精密元器件而设计。本产品将高导热能力与极致的凝胶级柔软度相结合，实现了低应力的完美贴合。它适用于解决高精密度组装中存在的巨大公差、不平整表面以及精密元件易受机械损伤等问题。

TIF®700PLUS 系列特性表			
产品特性	典型值		测试方法
颜色	灰色		目视
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶		-
厚度范围 (inch/mm)	0.020~0.030 0.50~0.75	0.040~0.200 1.00~5.00	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	50	20	ASTM D2240
密度 (g/cm³)	3.45		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200		-
击穿电压 (V/mm)	≥5500		ASTM D149
介电常数 @1MHz	8.0		ASTM D150
体积电阻率 (Ohm·cm)	> 1.0×10¹²		ASTM D257
导热系数 (W/m·K)	7.5		ASTM D5470
	7.5		ISO22007
阻燃等级	V-0		UL94 (E331100)

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.020" (0.50 mm) ~0.200" (5.00 mm) , 以 0.010" (0.25 mm) 为增量。

标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)

零件编码:

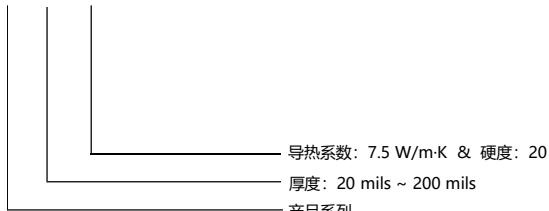
涂层处理: NS1 (无粘性涂层) 、 DC1 (单面加硬)

胶层处理: A1/A2 (单面/双面带胶黏剂)

TIF®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息, 请与本公司联系。

产品型号说明

TIF7 00 PUS



全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208

台湾: +886-2-2277-1007

加拿大: +001-604-2998559

越南: +84-396852859

service@zitek.com

www.zitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的, 产品规格可能因技术改动或优化而调整, 恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担, Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证, 亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。

